

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6	~	18	GHz
插入损耗		0.5		dB
隔离度		20		dB
输入驻波比		1.5		
输出驻波比		1.5		
幅度平衡			0.2	dB
相位平衡			±3	°

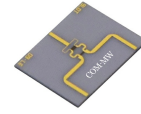
其它参数

功率容量	2W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	微带焊盘
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
质量等级	普军级
其它	陶瓷薄膜工艺

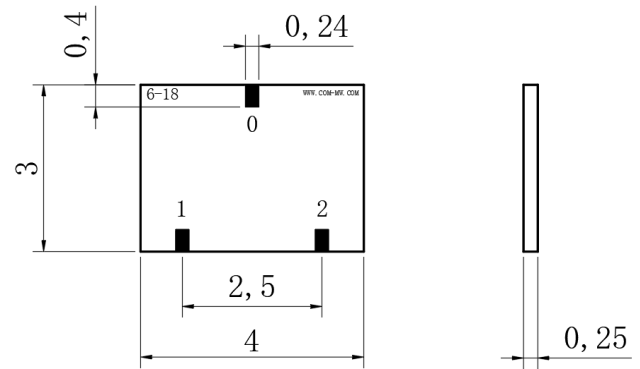
端口定义

公共端口	0
分配端口	1, 2

参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖1-2mm
2	芯片推荐使用低应力导电胶（ME8456）粘结
3	芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/C°）接近的载体，载体厚度≥0.2mm
4	电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，尺寸如下：